

【名稱】：TQFP/EQFP/LQFP176 (160、144、128、120、112、1

00) 轉 DIP

【描述】：

- 板材：FR4 板材，板色：黑色，板層：2 層，板厚：1.6mm，銅厚：1OZ，焊盤：採用化學沉金工藝（即焊盤表面特殊鍍金）
- 尺寸：61.25*61.25*1.6mm
- 用途：本轉接板適用於以下晶片封裝【①、Pitch（腳與腳間距）=0.5mm 的 TQFP100、TQFP112、TQFP120、TQFP128、TQFP144、TQFP160、TQFP176；②、Pitch（腳與腳間距）=0.5mm 的 LQFP100、TQFP112、LQFP120、LQFP128、LQFP144、LQFP160、LQFP176】
- 特點：可支援多個貼片封裝晶片轉外掛程式（但每個板一次只能焊接一個晶片轉外掛程式）。

